

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2009年9月24日(24.09.2009)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2009/116426 A1

(51) 国際特許分類:

C25D 7/00 (2006.01) H01L 23/50 (2006.01)
C25D 3/56 (2006.01) H05K 1/09 (2006.01)
C25D 5/12 (2006.01) H05K 3/24 (2006.01)
H01L 23/12 (2006.01)

貴由(MICHINO, Takayoshi) [JP/JP]; 〒1630558 東京都新宿区西新宿一丁目2番2号 松田産業株式会社内 Tokyo (JP). 鈴木 岳彦(SUZUKI, Takehiko) [JP/JP]; 〒1630558 東京都新宿区西新宿一丁目2番2号 松田産業株式会社内 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2009/054510

(22) 国際出願日: 2009年3月10日(10.03.2009)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2008-071975 2008年3月19日(19.03.2008) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 松田産業株式会社(Matsuda Sangyo Co., Ltd.) [JP/JP]; 〒1630558 東京都新宿区西新宿一丁目2番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 高柳 守(TAKAYANAGI, Mamoru) [JP/JP]; 〒1630558 東京都新宿区西新宿一丁目2番2号 松田産業株式会社内 Tokyo (JP). 小田 和弘(ODA, Kazuhiro) [JP/JP]; 〒1630558 東京都新宿区西新宿一丁目2番2号 松田産業株式会社内 Tokyo (JP). 道野

(74) 代理人: 吉武 賢次, 外(YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル323号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

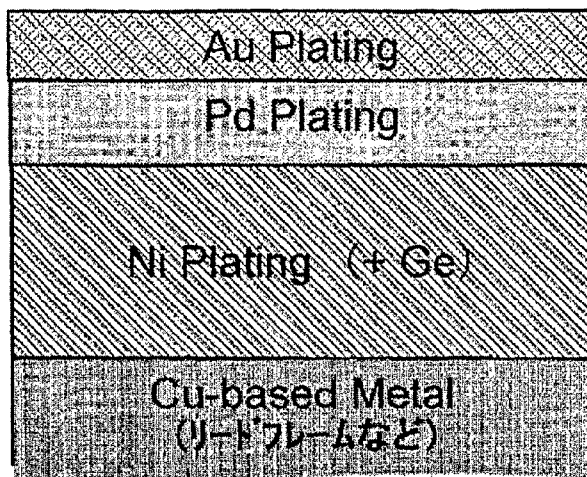
(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

[続葉有]

(54) Title: ELECTRONIC COMPONENT AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(54) 発明の名称: 電子部品およびその製造方法

[図 1]



AA

AA Cu-based Metal (LEADFRAME OR THE LIKE)

(57) Abstract: An electronic component is characterized in that a nickel plating film containing germanium is formed on a conductive base material surface of a connecting terminal section. In the electronic component, on the conductive base material surface of the connecting terminal section, the plating film having excellent heat resistance and solder wettability is formed.

(57) 要約: 本発明による電子部品は、接続端子部の電導基材表面上に、ゲルマニウムを含むニッケルめっき被膜が形成されてなることを特徴とする。本発明によれば、接続端子部の電導基材表面上に、耐熱性および半田濡れ性に優れためっき被膜が形成された、電子部品を提供することことができる。

WO 2009/116426 A1



GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, 添付公開書類:

NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD,
TG).

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))